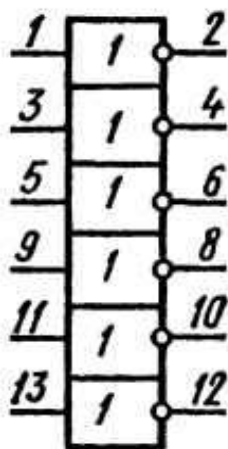


# КР1533ЛН8, КФ1533ЛН8, ЭКФ1533ЛН8

Микросхемы представляют собой шесть инверторов с повышенной нагрузочной способностью. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный 1; 2 - выход информационный 1; 3 - вход информационный 2; 4 - выход информационный 2; 5 - вход информационный 3; 6 - выход информационный 3; 7 - общий; 8 - выход информационный 4; 9 - вход информационный 4; 10 - выход информационный 5; 11 - вход информационный 5; 12 - выход информационный 5; 13 - вход информационный 6; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛН8, КФ1533ЛН8, ЭКФ1533ЛН8

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ..... 5 В  $\pm$  10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 12$  мА .....  $\leq 0,4$  В

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 24$  мА .....  $\leq 0,5$  В

Выходное напряжение высокого уровня:

- при  $I_{\text{вых}}^1 = -3$  мА .....  $\geq 2,4$  В

- при  $I_{\text{вых}}^1 = -15$  мА .....  $\geq 2$  В

- при  $I_{\text{вых}}^1 = -0,4$  мА .....  $\geq 2,5$  В

Ток потребления при низком уровне выходного

напряжения при  $U_{\text{п}} = 5,5$  В .....  $\leq 12$  мА

Ток потребления при высоком уровне выходного

напряжения при  $U_{\text{п}} = 5,5$  В .....  $\leq 3$  мА

Ток потребления в состоянии «выключено»

при  $U_{\text{п}} = 5,5$  В .....  $\leq 20$  мА

Входной ток низкого уровня .....  $\leq | -0,1 |$  мА

Входной ток высокого уровня .....	≤ 20 мкА
Выходной ток .....	-30  ...  -112  мА
Время задержки распространения сигнала при включении .....	≤ 14 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении .....	≤ 7 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния «выключено» в состояние низкого уровня .....	≤ 30 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния «выключено» в состояние высокого уровня .....	≤ 25 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние «выключено» .....	≤ 25 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня в состояние «выключено» .....	≤ 40 нс
Емкость входа .....	≤ 5 пФ

### **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Максимальный выходной ток высокого уровня .....	-15  мА
Максимальный выходной ток низкого уровня .....	24 мА
Напряжение питания .....	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня .....	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня .....	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход .....	5,5 В
Температура окружающей среды .....	-10...+70 °С

### **Общие рекомендации по применению**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В  $\pm$  10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.